

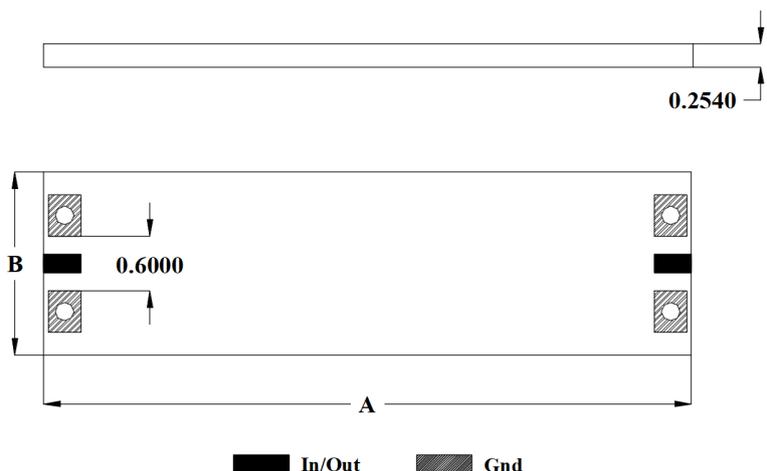
技术指标（常温+25°C）

序号	项目	技术指标
1-1	产品名称	薄膜低通滤波器
1-2	产品型号	YTFLP23-15
1-3	截止频率 f_0	23.0 GHz
1-4	工作频率	DC~23.0 GHz
1-5	通带损耗	$\leq 3.0\text{dB}$
1-6	带内波动	$\leq 3.0\text{dB}$
1-7	群延时波动	$\leq 1.0\text{ ns}$
1-8	带外抑制	$\geq 40\text{dBc}@26.7-38.0\text{GHz}$;
1-9	带内驻波比	≤ 1.7
1-10	输入输出阻抗	50 欧姆
1-11	输出安装方式	键合
1-12	产品尺寸	6.0mm*2.0mm*0.254mm

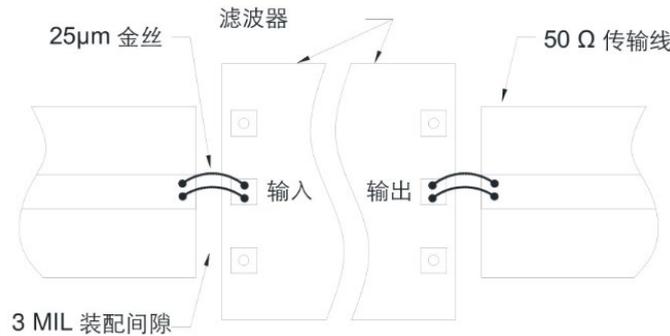
环境参数

2-1	工作温度	-45°C~+85°C
2-2	存储温度	-55°C~+125°C
2-3	最高输入功率	35dBm

外形尺寸

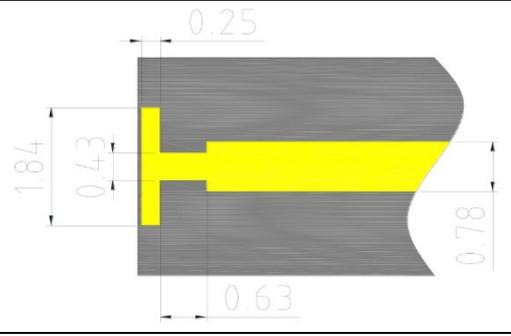
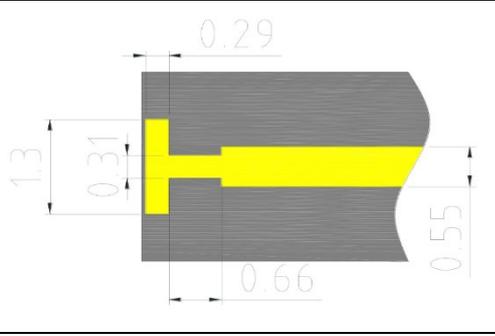
3-1	外形尺寸	见下图（A、B 外形公差： $\pm 0.1\text{mm}$ ）
		
3-2	标识尺寸	A: 6.0mm B: 2.0mm （图中尺寸单位为 mm, A、B 外形公差： $\pm 0.1\text{mm}$ ）
3-3	基板材料	陶瓷
3-4	表面处理	镀金

建议装配图



注意事项

- 1、芯片建议分腔使用，两侧距离侧壁0.1mm左右，表面距离上盖板1.75mm左右，芯片端口可互换；
- 2、芯片应安装在可伐或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载片上，载体厚度≥2mm；
- 3、芯片推荐使用低应力导电胶粘接；
- 4、电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型节尺寸如下：

电路板Rogers5880，10mil厚	电路板Rogers4350，10mil厚
	
适用频率：DC-38GHz	适用频率：DC-32GHz
注：T型图形顶端基板白边50um；频率10GHz以下无需匹配	

仿真曲线:

